



journal6 » 2004, Vol. 24 » Issue (3): 36-42

[论文](#)

[本期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

[« 前一篇](#) | [后一篇 »](#)

### Ti 和Ti /Ni /Ti 连接钨与铜及其合金的界面结合机制与接头强度

邹贵生, 赵文庆, 吴爱萍, 张德库, 胡乃军, 黄庚华, 任家烈

清华大学 机械工程系, 北京, 100084

Interfacial bonding and strength of tungsten to copper or its alloy joints with Ti foil and Ti/Ni/Ti multiple interlayers

ZOU Gui-sheng, ZHAO Wen-qing, WU Ai-ping, ZHANG De-ku, HU Nai-jun, HUANG Geng-hua, REN Jia-lie

Department of Mechanical Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献](#)

[相关文章 \(15\)](#)

中国航空学会 主办

中航工业北京航空材料研究院 承办

版权所有 © 《航空材料学报》编辑部 总访问量:

地址: 北京81信箱62分箱 邮政编码: 100095

电话: 010-62496277 传真: 010-62456212 E-mail: hkclxb@biam.ac.cn

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持: support@magtech.com.cn